

技 术 开 发 合 同

合同编号：11N05505885920263801

项目名称：硬X射线自由电子激光装置-大口径光学元器件拆装系统

甲方：上海科技大学

乙方：沈阳工业大学

(法人姓名：张珂，男)

有效期限：自合同签订日起-2030.09.30

上 海 市 科 学 技 术 委 员 会
上 海 市 工 商 行 政 管 理 局

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就 硬 X 射线自由电子激光装置（以下简称：SHINE）大口径光学元器件拆装系统的技术开发经协商一致，签订本合同。

一、工作内容、方式和要求：

甲方委托乙方承担硬 X 射线自由电子激光装置（以下简称：SHINE）大口径光学元器件拆装系统的技术开发工作。

具体工作内容及要求详见附件 1“技术说明书”。

附件 1、技术说明书

附件 2、SHINE 项目合同执行情况反馈表

附件 3、安全施工协议(若有)

附件 4、保密协议(若有)

二、工作条件和协作事项

1. 双方责任

1.1 甲方责任

- (1) 提供技术规格要求。
- (2) 审批承制方的技术设计，制造计划和制造工艺。
- (3) 制造过程中进行质量跟踪。
- (4) 对装置做最终验收。

1.2 乙方责任

- (1) 项目计划、组织及管理。
- (2) 装置技术设计和工艺设计及评审。
- (3) 提出装置与相关系统的技术接口。
- (4) 装置制造。

- (5) 现场安装和调试。
- (6) 为甲方人员现场跟踪提供条件。
- (7) 定期提交项目进展报告。
- (8) 交付产品及技术文件。
- (9) 交付后提供售后服务

2. 风险责任

本项目的管理风险和有关人员的人身安全由乙方承担；合同执行期间，本项目的技术风险由乙方承担，如因设计问题导致系统不能按要求正常运行，责任由乙方承担。

3. 质量保证

本合同项目的保证期详见附件 1“技术说明书”。

在保证期内，当大口径光学元器件拆装系统出现运行问题时，乙方应协助甲方调查与分析问题的原因，提出解决问题的方法，积极提供技术指导。若属乙方责任，乙方应在接到通知后 48 小时内到达现场处理，在最短时间内，使系统恢复正常工作。因此而发生的人工费、差旅费等由乙方承担。

甲方存在任何有关大口径光学元器件拆装系统的技术疑问，乙方将及时、积极地提供技术指导。

4. 知识产权与技术资料所有权

在执行本合同期间完成的技术成果与技术资料归甲方。因本工程需要，甲方有权在不征得乙方同意的情况下，向第三方公开有关本项目的技术资料 and 图纸，但第三方不得以任何形式向外扩散或转移。

5. 技术保密

甲方在合作期向乙方提供的相关技术材料及信息在没有征得甲方同意的情况下，乙方不得以任何形式向第三方扩散或转移。

三、履行期限、地点和方式：

1 本合同自签订起至 2027 年 9 月在甲方指定的场地履行。参考国家法定工作时间，甲方有需求时可协商加班。

2 本合同的履行方式：乙方派出人员在甲方技术培训后开展工作。听从甲方工作安排。

四、验收标准和方式：

详见附件 1“技术说明书”。

五、报酬及其支付方式：

（一）本项目报酬（大写）为人民币 4180000 元（大写：肆佰壹拾捌万元整）。

（二）支付方式（采用以下第 ② 种方式）

①一次总付：

②分期支付：详见合同补充条款。

③其他方式：

六、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定，承担违约责任。

（一）违反本合同各条约定，双方应承担以下违约责任：

1. 除因不可抗力外，若乙方不能按合同规定时间提交合同约定的技术文件或产品或完成服务，应向甲方支付逾期赔偿金，逾期赔偿金按合同总价每周 0.5%计提，从合同款中扣除，最高限度为 10%，一旦达到逾期赔偿金最高限度，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因逾期所受损失。
2. 合同生效后，乙方单方提出解除合同的，将按项目合同款作双倍赔偿，还应按照合同法有关规定赔偿甲方损失。
3. 如因甲方原因造成的延误，可作相应的时间节点顺延。

4. 如果在本合同执行过程中，有事实证明乙方已没有能力按照合同完成相关任务，并将影响 SHINE 工程的进度，则甲方有权终止合同，并将部分或全部转交给其它厂家执行。这种情况下乙方应归还甲方已经支付的所有款项，并赔偿甲方由此造成的损失。

(二) 其它：无

七、合同争议的解决方式：

在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可以通过和解或者调解解决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第 (一) 种方式解决。

(一) 双方同意由 上海 仲裁委员会仲裁。

(二) 向人民法院起诉，约定_____人民法院管辖。

①被告住所地 ②合同履行地 ③合同签订地

④原告住所地 ⑤标的物所在地

八、其他（上述条款未尽事宜）：

合同补充条款：

补充条款

1:提供分项报价表附在本合同最后一页；

2、合同付款方式：

第一次付款：合同签订后，甲方三十个工作日内其向乙方支付合同金额的 20%；

第二次付款：乙方完成大口径光学元器件拆装系统技术方案和工艺设计方案评审，且验收大纲经甲方审定后，甲方三十个工作日内向乙方支付合同总金额的 30%；

第三次付款：乙方完成出厂验收且验收合格后，甲方三十个工作日内向乙方支付合同总金额的 20%；

第四次付款：乙方交付全部产品并完成安装调试，经甲方最终验收合格，且收到乙方提供的全额发票（增值税专用发票）后，甲方三十个工作日内向乙方支付合同总金额的 20%；

第五次付款：最终验收合格满 1 年且甲方确认无质量等其他问题后，甲方三十个工作日内向乙方支付合同总金额的 10%。

3、增值税专用发票税率：13%

4、本合同经双方代表签字后即生效，合同一式六份，甲方执三份、乙方执三份。

甲方：上海科技大学

乙方：沈阳工业大学

委托代理人：赵振堂

委托代理人：王佳

签订时间：2026年08月10日

签订时间：2026年08月10日

所在地：华夏中路 393 号

银行名称：建行铁西支行

银行账号：21001400008059610002